

Edição Número 159 de 17/08/2007
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Gabinete do Ministro

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 148, DE 15 DE AGOSTO DE 2007

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 16 e 18 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MDIC nº 52000.000730/2003-65, de 13 de janeiro de 2003, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para o produto TERMINAL DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DÉBITO E CRÉDITO estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 334, de 25 de outubro de 2005, passa a ser o seguinte:

I montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

II - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e

III - integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação do produto final, montadas de acordo com os incisos I e II anteriores.

Parágrafo único. As atividades ou operações inerentes às etapas de produção acima descritas poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, exceto a etapa III, que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 2º Ficam temporariamente dispensados da montagem os seguintes módulos ou subconjuntos:

I - leitor de cartão inteligente smart card;

II - leitor de código de barras;

III - dispositivo de cristal líquido ou de plasma;

IV - cabeça de impressão térmica; e

V - mecanismo impressor com capacidade de impressão máxima de até 6 (seis) cm de largura.

Art. 3º Fica dispensada a montagem da placa de circuito impresso destinada aos terminais de transações eletrônicas que implemente a função de criptografia dos dados e segurança,

desde que o fabricante execute, internamente ou por terceiros, as etapas de injeção plástica das tampas superior e inferior do gabinete e a montagem da fonte de alimentação.

§ 1º Ficam dispensadas, até 31 de dezembro de 2008, a montagem das placas de circuito impresso que implementem função de comunicação com tecnologia sem fio Wi-Fi, Bluetooth, WiMax, e outras tecnologias.

§ 2º Os módulos de comunicação GSM (Global System for Mobile Communication) utilizado nos produtos de que trata o caput deste artigo, deverão cumprir o Processo Produtivo Básico, a partir de 1º de janeiro de 2007, nos percentuais, conforme cronograma abaixo, calculados com base na produção total, em quantidade, no ano calendário.

I - De 1º de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2007: percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento); e

II - A partir de 1º de janeiro de 2008 em diante: percentual mínimo de 90% (noventa por cento).

§ 3º A fonte de alimentação de que trata este artigo deverá cumprir o processo produtivo básico descrito no caput do art 1º desta Portaria e, adicionalmente, o transformador utilizado na fabricação da fonte de alimentação deverá ser fabricado a partir do bobinamento do carretel.

Art. 4º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, através de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.

Art. 5º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 334, de 25 de outubro de 2005.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUEL JORGE

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

SERGIO MACHADO REZENDE

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia